



\*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen.  
 printed circuit board layout, components side view  
 modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
<b>P 133</b>	<b>8</b>	<b>90</b>

Verpackung: lose im Kunststoffbeutel  
 Packaging: in bulk, in a plastic bag  
 Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique

**P 133**

Modular-Einbaukupplung, 8p8c (RJ45), abgewinkelte Ausführung, mit Flansch, für Leiterplatten

**1. Werkstoffe**

Kontaktträger  
 Kontakt

PBT GF, V0 nach UL 94  
 CuSn, unternickelt und selektiv  
 vergoldet

**2. Mechanische Daten**

Kontaktierung mit

Modularstecker P 129

**P 133**

Modular chassis socket, 8p8c (RJ45), angular version, with flange, for printed circuit boards

**1. Materials**

Body  
 Contact

PBT GF, V0 acc. to UL 94  
 CuSn, pre-nickelated and selectively  
 gilded

**2. Mechanical data**

Mating with

modular plug P 129

**P 133**

Embase femelle modulaire, 8p8c (RJ45), version angulaire, avec collet, pour cartes imprimées

**1. Matériaux**

Corps isolant  
 Contact

PBT GF, V0 suivant UL 94  
 CuSn, sous-nickelé et doré sélective-  
 ment

**2. Caractéristiques mécaniques**

Raccordement avec

connecteur modulaire mâle P 129